

中国集成电路创新联盟

大联盟字[2025]4号

关于举办首届(2025)集成电路产业创新展的通知

各有关单位:

为积极响应国家集成电路创新发展战略部署,推动我国集成电路技术创新与产业升级,加强产业链上下游交流与合作,集成电路创新联盟将与中国国际光电博览会(CIOE)合作,在CIOE同期联合举办“首届(2025)集成电路产业创新展”,打造具有一定规模、覆盖全产业链、以科技创新为主旨的集成电路产业展览活动,以展示行业最新技术、产品和解决方案。双展联动共同打造32万m²光电技术与半导体产业链的展示盛宴,将进一步促进集成电路产业与相关产业的融合发展,助力提升集成电路产业的核心竞争力,支撑我国集成电路产业高质量发展。

一、活动概况

名称: 首届(2025)集成电路产业创新展

时间: 2025年9月10-12日,展期3天

地点: 深圳国际会展中心(宝安新馆,广东省深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号)

预计规模: 6万平方米主题展览区,1000家参展企业,双展预计吸引超过16万名观众

二、活动组织

主办单位: 中国国际光电博览会(CIOE)、集成电路创新联盟

承办单位：爱集微咨询(厦门)有限公司(集成电路投资创新联盟秘书处挂靠单位)

支持单位：集成电路设计创新联盟、集成电路封测创新联盟、集成电路装备创新联盟、集成电路材料创新联盟、集成电路零部件创新联盟、集成电路检测与测试创新联盟、集成电路投资创新联盟、示范性微电子学院产学研融合发展联盟、汽车芯片产业创新战略联盟

三、展览活动安排

1.总体规划

展览规模 6 万平米，设置六大集成电路展区及专题展区，覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料等产业链各环节。

2.展区设计

(1) 创新综合展区：从 IC 设计到制造，展示近年来集成电路领域的重大科技创新成果，可采用高科技展示手段，如全息投影、VR/AR 体验等，增强参观的沉浸感和互动性。

(2) 设计与应用展区：物联网、人工智能、汽车电子、智慧城市、智能终端、健康医疗、工业应用，通过实物展示、案例分享等形式，展现集成电路技术如何赋能各行各业。

(3) IC 制造展区：半导体制造工艺、半导体封装工艺与测试技术等，同时介绍绿色制造、智能制造等新型制造模式。

(4) 晶圆设备展区：半导体晶圆设备等，专注于晶圆加工过程中所需的各种精密设备。

(5) 封测设备展区：半导体封装设备、半导体测试设备、IC 测试仪器，包括先进封装工艺（如 SiP、3D 封装）设备等。

(6) 核心部件与材料展区：聚焦于集成电路制造中的关键原材料、部件及辅助材料，如单晶硅、硅片等。

3.专题展区

(1) 化合物半导体专区：注重化合物半导体材料（如 GaN、SiC 等）及其相关产品的展示，包括功率器件、射频器件及相关上游设备材料等。

(2) 汽车芯片专区：全面展示汽车芯片领域的最新成果与应用，设立“汽车芯片生态圈”展示区，展示芯片制造商、汽车整车厂、零部件供应商等产业链上下游企业的紧密合作与协同发展。

(3) 创新产品发布专区：对新产品、新技术、新项目进行发布，展示集成电路产业的新品成果和案例。同时，提供知识产权咨询和服务。

(4) 智能家电芯片、人工智能芯片等专区，具体以实际为准。

4.展位报价等

(1) 标准展位市场价格：25800 元（人民币）/9 m²。联盟成员单位享受 9 折优惠；

(2) 光地展位市场价格：2580 元（人民币）/m²。联盟成员单位按面积享受一定折扣，36 平米以上可享受更多优惠；

(3) 广告赞助方案等具体可咨询联系人。

四、同期会议活动安排

1. 开展仪式

时间：9 月 10 日 10:30

地点：深圳国际会展中心（宝安新馆）北登陆大厅

2. 其他，同期举行第 26 届中国国际光电博览会（CIOE），大联盟及专业联盟等相关会议活动后期将进一步通知。

五、参展报名

请有意向参加首届(2025)集成电路产业创新展的单位填写报名表（附件 1），并于 **2025 年 5 月 31 日**前将报名表反馈至邮箱 lijy@ijiwei.com，便于预留展位以及跟进后续布展等事宜，欢迎大家积极报名参展。

联系人：

李静雅（爱集微），13439333369，lijy@ijiwei.com

由春娟（大联盟），18210529773，youchunjuan@ime.ac.cn

附件：1. 参展企业报名表

2. 中国国际光电博览会(CIOE)相关介绍

集成电路创新展组委会

（承办单位：爱集微咨询(厦门)有限公司）

2025 年 4 月 10 日

附件 1

首届(2025)集成电路产业创新展 参展企业报名表

公司名称			所在地区	
公司简介				
成立年份		所属联盟		
公司地址				
拟参展展品所属类别(在选定项目打“√”或涂黑)	☐ 创新综合展区 ☐ 设计与应用展区 ☐ IC 制造展区 ☐ 晶圆设备展区 ☐ 封测设备展区 ☐ 核心部件与材料展区 主题展区 (☐ 化合物半导体专区 ☐ 汽车芯片专区 ☐ 创新产品发布专区 ☐ 智能家电芯片 ☐ 人工智能芯片 ☐ 其他_____) 拟需展位: 标准摊位 (9 平米/个) ____个; 光地: ____平方米			
展品名称				
联系方式	姓名: 电话: 手机: E-mail:			
代表签字: 日 期: 年 月 日				

附件 2

中国国际光电博览会(CIOE)相关介绍

中国国际光电博览会（CIOE）是经国家科技部批准、商务部备案，由两院资深院士王大珩先生担任主席团终身名誉，科技部原副部长曹健林先生担任主席团主席的具有国际影响力的权威盛会。自 1999 年创办以来已成功举办二十五届，第二十五届展出规模达 24 万平米，吸引国内外知名光电参展企业 3000 多家，超 13 万专业观众，展示及交流领域涉及信息通信、精密光学、智能制造、激光、红外、生物光子、光电传感、新型显示、移动互联网与物联网等光电技术全产业链，链接全球光电资源，创新技术及科研成果展示，是全球光电行业风向标。

第二十六届 CIOE 将于 2025 年 9 月 10-12 日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举办。作为覆盖光电全产业链的综合型展会，CIOE 将首次与中国集成电路创新联盟（大联盟）合作，在 CIOE 光博会同期联合举办“第七届深圳国际半导体展 SEMI-e 暨 2025 集成电路产业创新展”，共同打造 32 万 m²光电技术与半导体产业链的盛宴。双展同期将更完善半导体产业链布局，共同服务于显示、数据中心、汽车等多个交叉领域的广泛观众，一站式高效赋能下游关键领域。